

LSIの故障解析サービス

ユーロフィンFQLは、単なる解析作業請負会社ではありません!!

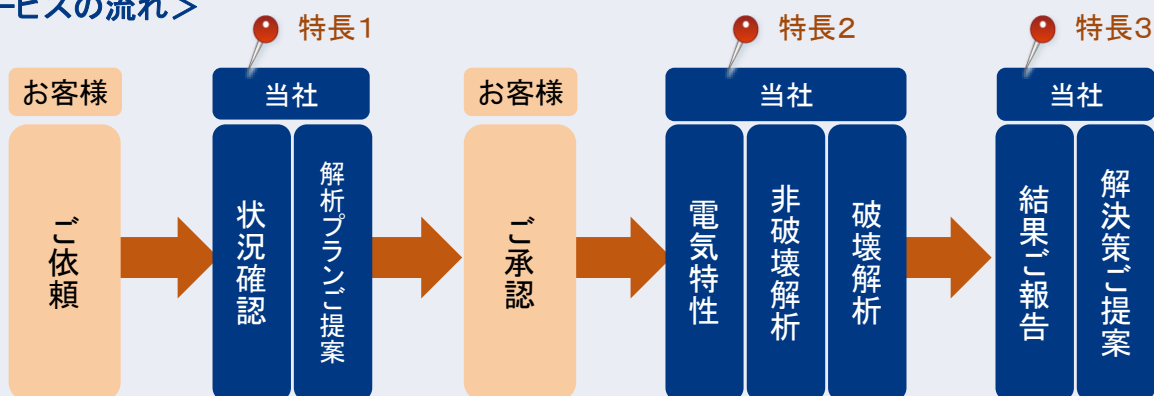
部材／半導体メーカーをはじめ、装置開発／設計／製造／品質保証の各部門と共に、数え切れない多くの問題を解決してきた経験豊富なスタッフが、解析はもちろん、あらゆる品質改善に至るまで、お客様のお悩み事を一からバックアップ致します。

こんなことでお悩みではありませんか？

- ・故障部品までは特定できたが、何故故障したのかが分からない
- ・単なる解析報告だけではなく、推定原因や発生メカニズムの考察を知りたい
- ・故障解析結果から製造プロセスの改善を行いたい
- ・再発防止のための改善施策や品質コンサルを頼みたい

発生状況からユーロフィンFQLのノウハウを最大限活用した解決方法をご提案します。

<サービスの流れ>



特長1

お客様からの情報を基に、まずは解析事例から故障原因を推定し、最適な解析方法をご提案します。
※お客様がご納得の上、ご指示頂けるまで作業は開始致しません。

特長2

解析途中で問題を検出した場合は、その時点で作業を一時中断し、真っ先にお客様へご連絡します。
※お客様とご相談の結果、以降の作業は不要とご判断された場合、たとえ当初のお見積もりに記載した作業があったとしても、以降の作業は行いません。また、差額が生じる場合は、再度お見積もりさせていただきます。

特長3

一連の作業終了後に報告書をご提出します。
またご要望により、解決に至るまで徹底的にサポートさせていただきます。
※別途費用が発生する場合がございます。

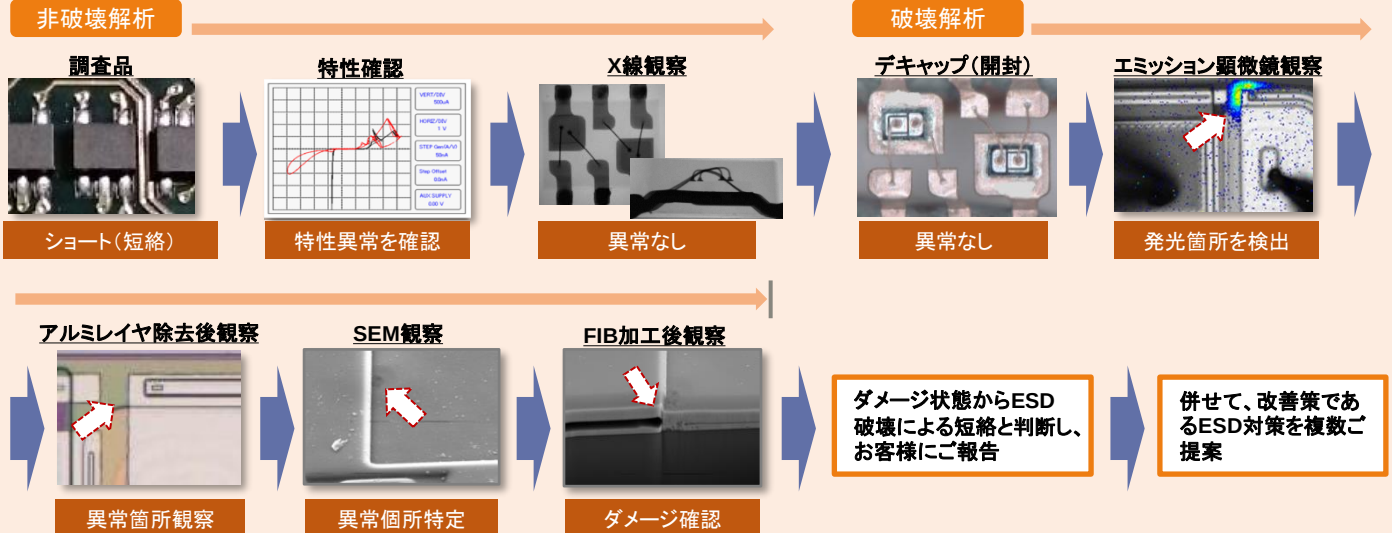
お客様のメリット

- ・解析時間と無駄なコストを抑制します。
- ・お客様の立ち会いも可能です。
- ・報告書は、解析結果だけではなく、発生メカニズムや問題解決に向けた施策等、お客様のご要望にことん応じます。
- ・必要に応じて、更なる詳細調査も可能です。
各種分析や回路検証もお任せ下さい。

解析内容

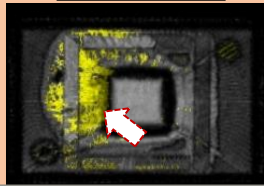
品質を支える当社の経験豊富なスペシャリスト陣が、お客様のご相談を承ります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お客様のご期待に応えられる最適な解析方法をカスタマイズし、ご提案させていただきます。

当社に於ける解析手法の一例として、外観だけでは異常を検出することができなかったトランジスタの解析事例をご紹介します。



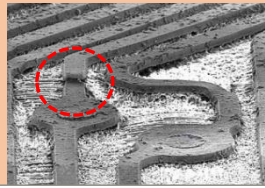
その他の解析事例

超音波探傷解析



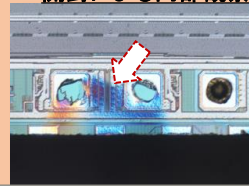
ICパッケージ内の界面剥離

SEM観察



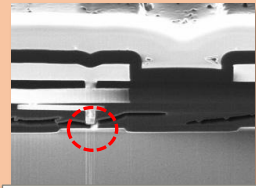
サブストレート基板配線断線

開封による内部観察



絶縁層間層(PSG層)の剥離

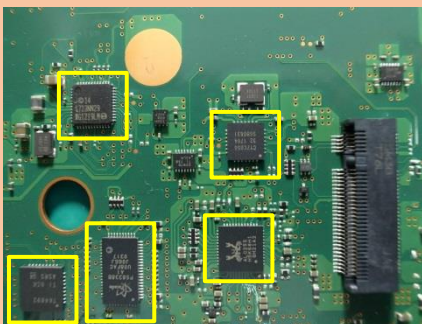
FIB-SIM観察



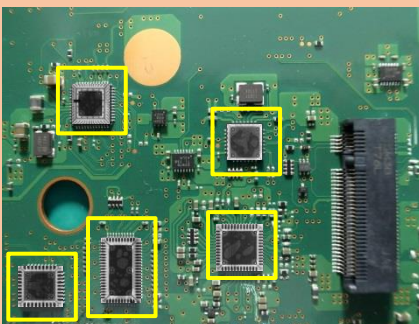
チップ内部の断線

デキャップ(開封)ソリューション 事例

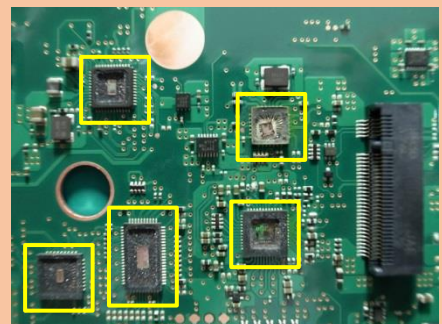
★回路基板にLSIを搭載したままの状態を開封することが可能です。



・開封前のLSI搭載状態



・開封前のX線透視観察



・回路基板に実装したままの状態で、対象LSIのみを開封可能

お問い合わせ先

ユーロフィンFQL株式会社

信頼性評価、環境試験、故障解析、品質保証サポート

<https://www.eurofins.co.jp/efql/contact>

9時～17時 土・日・祝日・当社指定の休業日を除く